PAT-NO:

JP362211914A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62211914 A

TITLE:

DEVICE FOR VAPOR GROWTH OF

SEMICONDUCTOR THIN FILM

PUBN-DATE:

September 17, 1987

omorina to the white a located by the terms of this stable in the enterprise.

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

IKEDA, MASAKIYO

KOJIMA, SEIJI

KASHIYANAGI, YUZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

krab ar na cyrthygydd y bbrei o'i rheny ir baeth wy i ar gwy gwy ii

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD: THE

Aller N/A

APPL-NO:

JP61053552

APPL-DATE:

March 13, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/205

US-CL-CURRENT: 118/715

ABSTRACT:

PURPOSE: To restrain a curl-up of a gas by making a flow of the gas in a reactor tube uniform by providing a shielding cylinder with through-holes of twice number as that of exhaust vents so as to divide the gas for exhaust.

CONSTITUTION: A shielding cylinder 15 is provided with through-holes of

twice number as that of exhaust vents 6 and which have roughly the same diameter as an inner diameter of the exhaust vents 6. A gas is divided to be exhausted from the through-holes 15a of the shielding cylinder 15 and this is equivalent to that the exhaust vents becomes twice and accordingly, a flow of the gas becomes uniform. As a result, a curl-up of the gas in the part where a gas velocity is slow is restrained.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-211914

SINL CI.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)9月17日

H 01 L 21/205

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 半導体薄膜気相成長装置

②特 顧 昭61-53552

❷出 願 昭61(1986)3月13日

70発明者 池田

正 潜

東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央

研究所内

@発明者 児島

誠 司

司 東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央

研究所内

@発明者 柏柳

雄三

横浜市西区西平沼町6番1号 古河電気工業株式会社横浜

電線製造所内

砂出 頤 人

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明和古

1.発明の名称

半導体等膜気相成長整置

2.特許請求の範囲

意臓気相成長装置において、排気口を設けた円 筒部の内側に円筒状しゃへい部を設け、験しゃへ い部に透孔を排気口の数の2倍数あけることによ り、均一排気することを特徴とする半導体薄膜気 相成長装置。

3 . 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体部関気相成長袋選に関するもの である。

(従来の技術)

使来の半導体療験気相處長用の反応炉を第8図 (A)、(B)、(C)に示す。第8図(A)において洗板1はカーボンサセプタ2上におかれ外部よりRFコイル3により、高周被誘導加熱され 所定の程度に保たれている。反応管4上部のガス 導入口23より、キャリアガスと共に導入された 原料ガス5は基板付近で熱分解等の反応をおこし 、基板1上に存限を堆積する。反応終了後のガス は排気口6より排気される。存限の均一性をあげ るために成長中はカーボンサセプタ2を回転シャ フト7で回転させる。8は冷却水である。

また第8図(B)はGaAs、GaAQAs 等の化合物半導体静臓の気相成長姿置を示さるのの類似成長変異なるとなった。 GaAs、GaAlAs等の静臓気相成長変異なるとなった。 は、反応性を空気にさらすと静臓の特性が劣化を は、反応性を空気にさらすと静臓の特性が劣化を ので、これを助止するため図示のように反はなって の下部に基板交換用のある。図はないでは 中の状態を示している。基板交換時間に マトアを下げ、ゲートバルブ10を閉じ、反応 マトアの途中に第8図(A)と阿様であるが、で シャフトアの途中にしない。 に 終了後のガスが前室9へ流れこんで反応を が 第3に付着するのを助止する構造になっている。

1

なお12は拡縦交換用窓フランジである。

次に第8図(C)は大量生産用の装置であり、キャップ138を有し角錐合状のカーボンサセプタ13のタ13が用いられ、そのカーボンサセプタ13の各側面に基板1が設置できるようになっている。 数値的には第8図(B)と同様である。なおこの場合反応管径が大きくなるので、図示のように排気口をを複数設け、ガスの流れが均一となる。ならにすることが好ましい。図中では排気口は2つとなっている。第8図(D)は第8図(C)の反応管の横断面図である。第8図(A)、(B)または(C)において同符号は同じものを示す。

第8図(A)~(D)において(ア)、(イ)
は反応等内のガス液を示す。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし第8日(A)、(B)の装置では反応管4の排気口傷(ア)と反対傷(イ)のガス速度は(ア)傷で大きくなり(イ)傷で小さくなる。このため(イ)傷でガスの巻き上りが見られ、反応管内壁のサセプタ2上液器に反応生成物が付着す

3

(実施例)

次に本発明を図示の実施例に従って説明す る。

第1回は従来の半導体療験気相成長装置のうち 前窓を存さない型(節8図(A)参照)に対応す る木発明の実施側の要部新函図であり、排気口取 り付け用円筒部14の内側にしゃへい用円筒部 15を設けて閉空間21ができる構造となってい る。しゃへい用円筒部15には排気口の内径と同 等の口径を有する透孔が排気口の数の2倍数あけ られている。第2図(A)は第1図のA-A 、線 虧耐器であり、第2箇(B)、(C)は他例の実 集倒である。阿図から明らかなように、しゃへい 円筒部15の透孔15aの位置は排気口6の間に くるよう(排気ロが2側以上の場合)、もしくは 透孔15aの間に排気口Bがくるよう(排気口 が1倍の場合)に配置される。第2因において (A)、(B)、(C) 社各々排気口1、2、3 値の場合である。第2図中にガスの流れを矢印で 示すが、しゅへい用円筒部1°5の透孔15aに分 る。一方第8図(C)では排気口6と排気口6の中間(イ)の部分(第8図(D)参照)で上記と同じことがいえる。反応管に付着した生成物は極めて不安定に付着しているため成長中に基板1上へ落下し薄膜の表面欠陥の原因となる。これを助止するにはガス変量を増加させればよいが、原料収率の低下がみられ経済性が損なわれる。また、排気口の数を増加させることも考えられるが、構造上の側約のためこの方法は困難が件なう。

(周囲点を解決するための手段)

本発明はこのような半導体機関気相成長 装置の 欠点に超みなされたものであり、これらの 従来の 半導体機関気相成長装置の欠点を解消する もので

すなわち太発明は、静殿気相成長装置において、排気口を設けた円筒部の内側に円筒状しゃへい部を設け、改しゃへい部に透孔を排気口の数の2倍数あけることにより、均一排気することを特徴とする半導体静膜気相成長装置を提供するものである。

4

留されて排気されることから、あたかも排気ロが 2倍になったのと等額となり、反応管中のガスの 茂れは均一となる。この結果、ガス速度の遅い部 分でのガスの巻き上げは抑餌される。

実際に第1図のようにしゃへい用円筒の内径を 反応管径に一致させた構造において以下のパラ メータを用いた場合、サセプタ上変観の反応管内 建への反応生成物の付着が防止でき、移聴の表面 欠略は減少した。

以下に第1回の装置における反応管径と排気口 数としゃへい用円筒部の透孔の孔径との関係を例 示する。

第3図は本発明の他例の要認斯図図であり、第 1図のしゃへい用円情部15に代えてろうと状 しゃへい体16を用い、その基部16mの内径 を反応替より小さくした例である。選孔は基準 16mに設けられる。この実施例によればろうと 状としてシャフト図辺から排気することによりガ スの流れの均一性が一層向上する。

これらの点以外は第2図の実施例と阿様であり、阿図と阿符号は同じものを意味する。

第4図は第8図(B)、(C)のように前室9 を有する半導体部膜気相成長装置における実施例 を示す要部断面図であり、17がしゃへい用円筒 部である。

また第5回はしゃへい用円筒部18と反応生成 物の前室への付着を防止するしゃへい板11を用 いて閉空間21をつくっている。しゃへい板11 は回転シャフト7に固定されている。

第4、5図ともしゃへい用円賃部17、18の 近孔の配置等は第2図と同様である。

第6図はさらに木発明の半さ体辞膜気相成長要置の他例を示す要認断面図であり、しゃへい用円 10部19の内側にさらに回様のしゃへい用円6部20を設けたものである。第7図に第8図の要置 のA-A・級断面図を示す。この場合しゃへい用 円筒部20の透孔20aの仮は先と同様にしゃへ い用円筒19の透孔19aの数の2倍とする。図

7

٥.

第8図(A)、(B)、(C)は従来の半導体 等限気相成長装置の断面図であり、第8図(D) は第8図(C)の反応管の横断面図を示す。 符号の説明

- 2---
- 4 … 反応管
- 5一原料ガス
- 6 -- 排気口
- 7…回転シャフト
- 9 -- 前家
- 11… しゃへい板
- 13…サセプタ
- 14…排気口取り付け用円賃部
- 15…しゃへい用円賃部
- 15 a --- 造孔

特許出願人 古河電気工業株式会社 代理人 弁理士 版 田 敏 主

中21、22は閉空間を示す。

第6図及び第7図において、上述した以外は 前配第1~5図について述べたものと回機である。

(発明の効果)

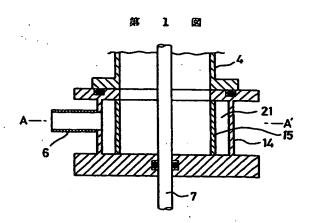
しゃへい用円筒部に排気口の2倍の数の透れをあけ、分割して排気することにより、反応管中のガスの変れが均一となり、ガスの巻き上げを抑制することができる。この結果反応生成物のサセプタ上流側への付着がなくなり、存膜の表面欠陥がなくなる。したがって本発明装置によれば、 原料 収率の低下を招くことなく高品質の半導体等 膜を成長させることができる。

4. 図面の簡単な説明

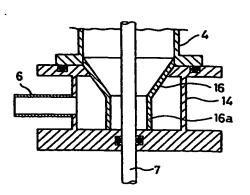
第1図は木発明の半導体の薄膜気相成長 装置の 実施例の製部所面図、第2図(A)は第1図のA - A 、線断面図、同図(B)、(C)は他例の断 面図である。

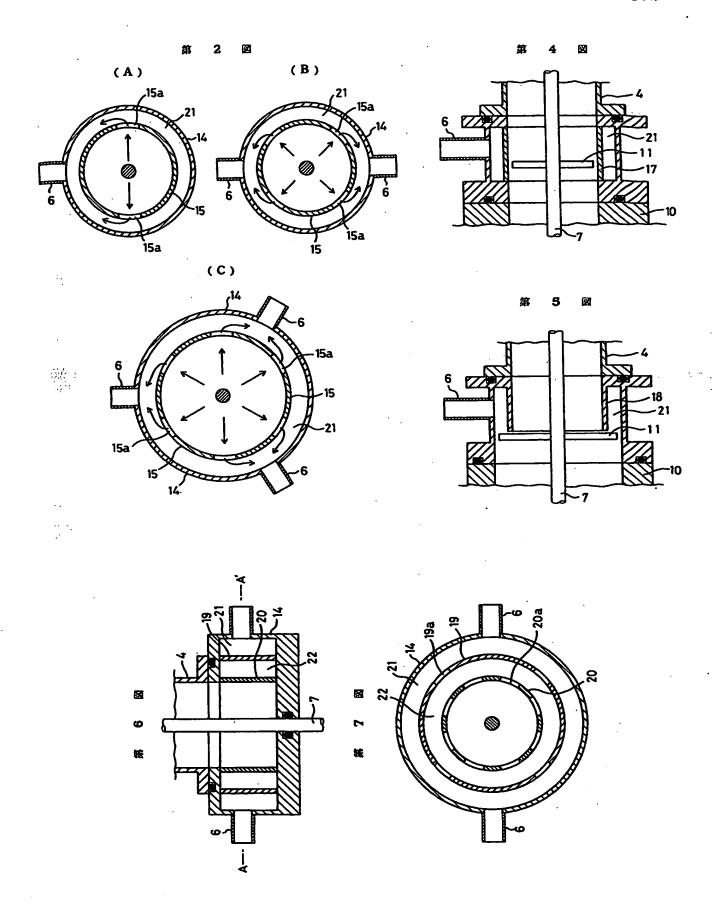
第3~第6図は本発明装置の他例の要部断 面図であり、第7図は第6図のA-A / 線断面図であ

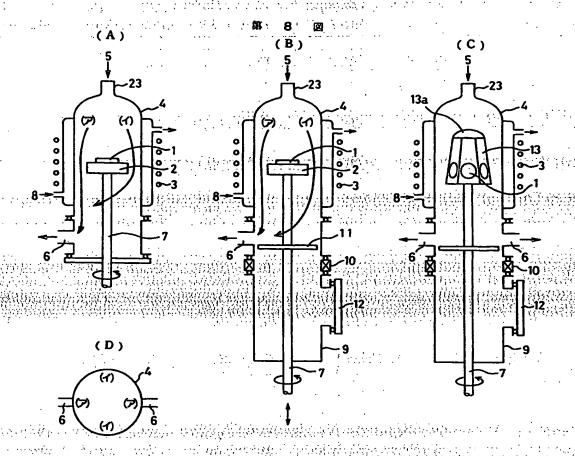
8



第 3 図







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
\square LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.